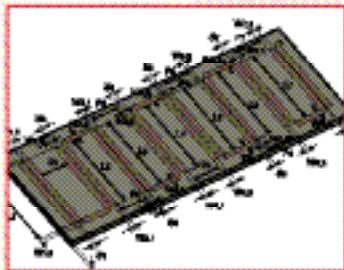


# ТЕХНОЛОГИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

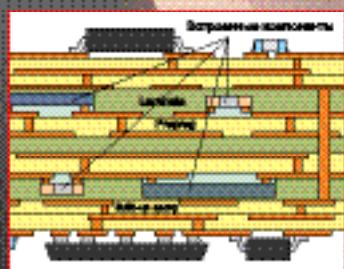
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ



Использование нанораспыльных технологий при идентификации печатных плат по их внешним признакам



Как отмычки могут влиять на надежность и себестоимость многослойного покрытия



Печатные платы.  
Встроенные компоненты



**ЭЛТЕХ**  
Санкт-Петербург

## СОЗДАНИЕ НАУКОЕМКИХ ПРОИЗВОДСТВ

ТРАНСФЕР

ИНЖИНИРИНГ

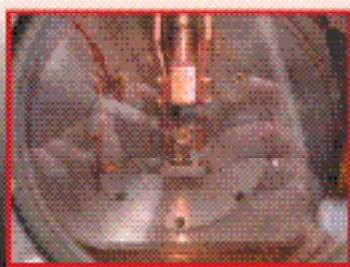
ОСНАЩЕНИЕ

- Трансфер передовых технологий нано- и микрозелектроники
- Внедрение перспективных материалов и прикладных разработок
- Отработка техпроцессов и маршрутов изготовления продукции
- Проектирование и управление проектами построения производств
- Создание и обслуживание чистых помещений и инженерной инфраструктуры
- Подготовка кадров и технологическое оснащение предприятий

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

НАНО- И МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

ФОТОВОЛЬТАИКА



office@eltech-spb.ru

Тел./Факс. (812) 322-85-85

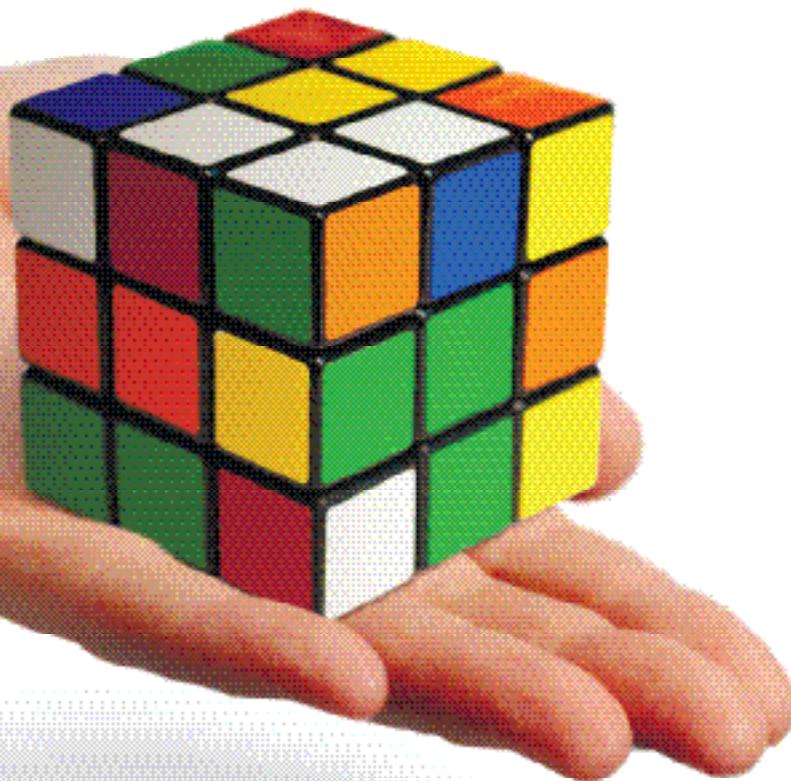
www.eltech-spb.ru

Монтаж полупроводниковых пакетов на адгезии с точностью соединения 1 мкм.  
Термическое и ультрафиолетовое отверждение

– Не «напрягайтесь»

Обращайтесь к нам

[www.pribor.ru](http://www.pribor.ru)



Все для производства  
электроники

 УНИВЕРСАЛ  
ПРИБОР

Санкт-Петербург: (812) 334 55 66

Москва: (495) 775 84 37

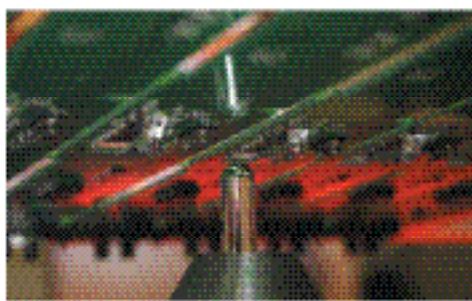
E-mail: [pribor@pribor.ru](mailto:pribor@pribor.ru)

**Системы селективной пайки  
волной припоя InterSelect —  
это разумный выбор  
и безупречное качество  
вашей продукции.**

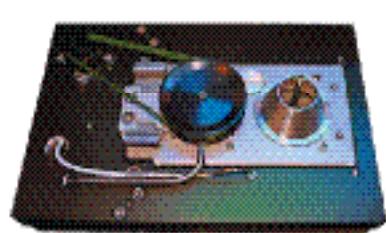


Идеально подходит для производств с большой номенклатурой изделий.

Рекомендуется для пайки плат со смешанным монтажом и плат с высокой плотностью монтажа компонентов.  
Обеспечивает качественную пайку с высокой повторяемостью.



- Система коррекции реперных знаков.
- Система автоматической компенсации прогиба ПП
- Система с дюймовыми модулями даёт возможность использовать разные насадки, для осуществления пайки плат с различной сложностью компоновки.
- Автомат оснащается программно регулируемой микрокапельной системой флюсования.
- Зона предварительного нагрева с регулировкой по ширине платы
- Возможна пайка в инертной среде. Подача азота осуществляется непосредственно в область пайки.
- Система управления температурой предпрогрева с обратной связью для верхней и нижней стороны. Слежение за уровнем температуры осуществляется при помощи пиromетра.
- Автоматический контроль и коррекция высоты волны позволяет выполнять пайку с высокой степенью повторяемости.
- Боковая камера для наблюдения процесса пайки.



IS-B-335  
IS-B-460